



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

笔电市场有望迎来回暖，建议关注汽车电子产业链

——电子行业周报（2023.6.19-2023.6.21）

增持（维持）

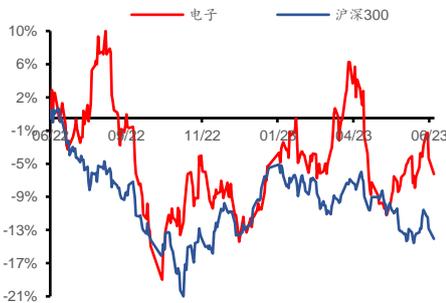
行业： 电子
日期： 2023年06月27日

分析师： 王珠琳
Tel: 021-53686405
E-mail: wangzhulin@shzq.com
SAC 编号: S0870523050001

联系人： 马永正
Tel: 021-53686147
E-mail: mayongzheng@shzq.com
SAC 编号: S0870121100023

联系人： 潘恒
Tel: 021-53686248
E-mail: panheng@shzq.com
SAC 编号: S0870122070021

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《AI服务器有望拉动存储行业复苏，OLED智能手机渗透率持续提升》

——2023年06月19日

《AI芯片贡献新成长动能，消费电子旺季袭来有望拉动上游回暖》

——2023年06月16日

《苹果新品发布有望提振消费市场，降本或促LED电影屏长远发展》

——2023年06月13日

核心观点

市场行情回顾

上周（06.19-06.21），SW电子指数下跌1.57%，板块整体跑赢沪深300指数0.93 pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子II、半导体涨跌幅分别为-1.49%、-1.15%、0.41%、-2.02%、-2.47%、-2.84%。从其他市场指数来看，整体维持弱势，费城半导体、台湾电子、恒生科技、道琼斯美国科技、纳斯达克指数周涨跌幅分别为-4.53%、-0.89%、-8.37%、-1.73%、-1.44%。

核心观点

面板：面板市场结构性涨价行情有望继续演绎。据 TrendForce 数据，23 年 6 月下旬，电视各尺寸面板价格继续上涨，部分显示器面板价格小幅上调，6 月 32/43/55/65 吋电视面板价格分别环比上涨 2/3/8/10 美元，而显示器面板在台厂连续两个月发动涨价影响下，韩厂与中国面板厂也开始释放涨价的想法。终端客户采购需求有望延续，进而支撑面板价格上行。

消费电子：全球笔电市场 Q2 出货量或将回暖，存储、CPU 等芯片以及零部件市场有望迎来改善。据 TrendForce 数据，23Q1 全球笔电出货量约 3390 万台，环比减少 13%，同比减少 39%，23Q2 预计笔电出货量提升至 3763 万台，环比增加 11%。部分品牌计划推出搭载 NVIDIA GeForce 40 系列中阶、入门款机型，消费市场逐步下沉。笔电整机及零部件渠道回补需求有望逐月增强，与此同时，受 AI 浪潮催化，笔电市场有望迎来新一波换机潮，部分笔电厂商如宏碁、惠普释出打造 AI 笔电的方向。

汽车电子：工信部支持 L3+ 车型商业化应用，新能源车购置税续免，汽车电子相关产业链有望充分受益。工信部表示支持 L3+ 自动驾驶功能商业化应用，并加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用；进一步完善网联基础设施，加快 C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设；深化测试示范应用，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，此外工信部还将发布新版的智能网联汽车标准体系指南，通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。

投资建议

维持电子行业“增持”评级，我们认为 2023 年电子半导体产业会持续博弈复苏；目前电子半导体行业市盈率依然处于 2018 年以来历史较低位置，同时风险也有望逐步释放。我们当前重点看好：半导体设计类标的和部分超跌标的里面行业轮动机会，AIOT SoC 芯片建议关注中科蓝讯和乐鑫科技；XR 产业链建议关注核心零部件供应商兆威机电；建议重点关注驱动芯片领域的峰昭科技、必易微、中微半导体、明微电子、汇成股份；半导体设备材料建议重点关注深科达、金海通、新益昌和华海诚科；建议关注国内头部功率供应商：时代电气，士兰微，新洁能，宏微科技，东微半导体，扬杰科技等，建议关注可立克，京泉华，江海股份等核心元器件供应商，同时建议关注 LED 产业链的兆驰股份、卡莱特和奥拓电子等个股。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期。

目 录

1 市场回顾	3
1.1 板块表现	3
1.2 个股表现	5
2 行业新闻	5
3 公司动态	7
4 公司公告	9
5 风险提示	9

图

图 1: SW 一级行业周涨跌幅情况 (06.19-06.21)	3
图 2: SW 电子二级行业周涨跌幅情况 (06.19-06.21)	3
图 3: SW 电子三级行业周涨跌幅情况 (06.19-06.21)	4
图 4: 其他市场指数周涨跌幅情况 (06.19-06.23)	4

表

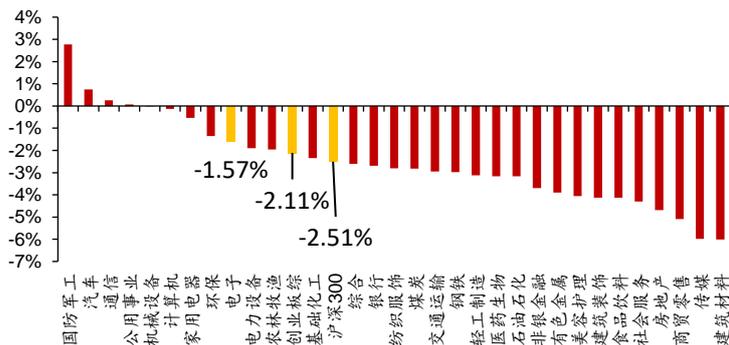
表 1: 电子板块 (SW) 个股上周涨跌幅前 10 名 (06.19-06.21)	5
表 2: A 股公司要闻核心要点 (06.19-06.21)	9

1 市场回顾

1.1 板块表现

上周 (06.19-06.21), SW 电子指数下跌 1.57%, 板块整体跑赢沪深 300 指数 0.93 pct、跑赢创业板综指数 0.54 pct。在 31 个子行业中, 电子排名第 9 位。

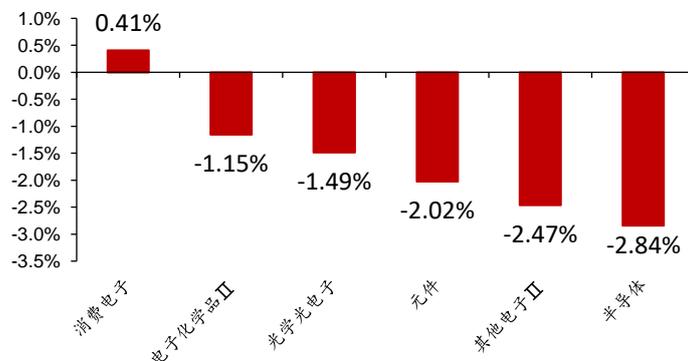
图 1: SW 一级行业周涨跌幅情况 (06.19-06.21)



资料来源: Wind, 上海证券研究所

上周 (06.19-06.21) SW 电子二级行业中, 消费电子板块上涨 0.41%, 涨幅最大; 跌幅最大的是半导体板块, 下跌 2.84%。光学光电子、电子化学品 II、消费电子、元件、其他电子 II、半导体涨跌幅分别为 -1.49%、-1.15%、0.41%、-2.02%、-2.47%、-2.84%。

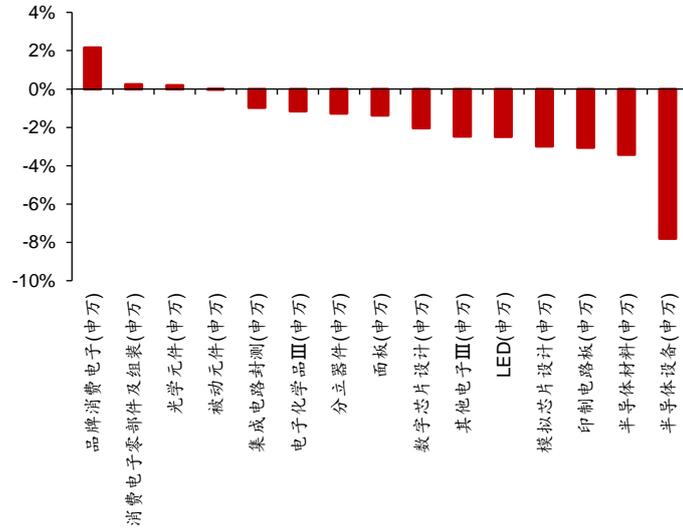
图 2: SW 电子二级行业周涨跌幅情况 (06.19-06.21)



资料来源: Wind, 上海证券研究所

上周（06.19-06.21）SW 电子三级行业中，品牌消费电子板块上涨2.16%，涨幅最大；涨跌幅排名后三的板块分别为半导体设备、半导体材料以及印制电路板板块，涨跌幅分别为-7.81%、-3.42%、-3.05%。

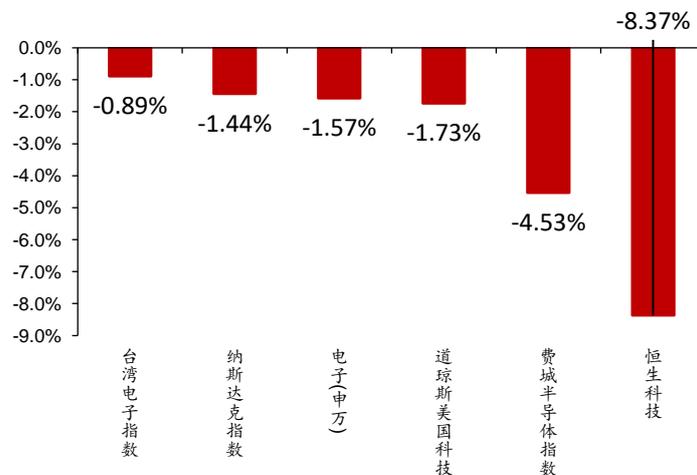
图 3：SW 电子三级行业周涨跌幅情况（06.19-06.21）



资料来源：Wind，上海证券研究所

从其他市场指数表现来看，整体维持弱势。费城半导体、台湾电子、恒生科技、道琼斯美国科技、纳斯达克指数上周（06.19-06.23）涨跌幅分别为-4.53%、-0.89%、-8.37%、-1.73%、-1.44%。

图 4：其他市场指数周涨跌幅情况（06.19-06.23）



资料来源：Wind，上海证券研究所

1.2 个股表现

上周（06.19-06.21）涨幅前十的公司分别是晶赛科技（31.77%）、可川科技（25.31%）、易天股份（23.48%）、福立旺（22.97%）、苏州固锴（22.37%）、惠伦晶体（19.65%）、峰昭科技（19.59%）、菲沃泰（16.53%）、奕东电子（15.43%）、东田微（15.40%），跌幅前十的公司分别是和林微纳（-20.09%）、利通电子（-14.09%）、睿能科技（-12.69%）、安集科技（-11.96%）、长川科技（-10.90%）、深科技（-10.46%）、纳芯微（-9.86%）、路维光电（-9.31%）、天禄科技（-9.07%）、芯源微（-8.80%）。

表 1：电子板块（SW）个股上周涨跌幅前 10 名（06.19-06.21）

周涨幅前 10 名			周跌幅前 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周涨幅(%)
871981.BJ	晶赛科技	31.77%	688661.SH	和林微纳	-20.09%
603052.SH	可川科技	25.31%	603629.SH	利通电子	-14.09%
300812.SZ	易天股份	23.48%	603933.SH	睿能科技	-12.69%
688678.SH	福立旺	22.97%	688019.SH	安集科技	-11.96%
002079.SZ	苏州固锴	22.37%	300604.SZ	长川科技	-10.90%
300460.SZ	惠伦晶体	19.65%	000021.SZ	深科技	-10.46%
688279.SH	峰昭科技	19.59%	688052.SH	纳芯微	-9.86%
688371.SH	菲沃泰	16.53%	688401.SH	路维光电	-9.31%
301123.SZ	奕东电子	15.43%	301045.SZ	天禄科技	-9.07%
301183.SZ	东田微	15.40%	688037.SH	芯源微	-8.80%

资料来源：Wind，上海证券研究所

2 行业新闻

全球前十大 IC 设计厂商第一季营收持平前季，第二季因 AI 需求带动有望止跌反转

6 月 20 日，集邦咨询表示，第一季供应链库存消化不如预期，且适逢传统淡季，整体需求清淡。不过，由于部分新品拉动，加上特殊规格急单带动，第一季全球前十大 IC 设计公司营收为 338.6 亿美元，持平 22Q4 营收，环比增长 0.1%。Cirrus Logic（思睿科技）跌出前十名之外，WillSemi（韦尔半导体）与美系电源管理 IC 厂 MPS（芯源系统）递补第九与第十名位置，其余排名并无变动。展望第二季，尽管 IC 库存去化速度较预期缓慢，但相较于 2022 年下半年库存高企时期，仍已陆续恢复至较为健康的水位。同时，部分 IC 设计厂在新品刺激下，营收有望朝正向增长。（资料来源：全球半导体观察，集邦咨询）

AI 芯片与 HBM 需求带动，预估 2024 年先进封装产能将提升 3~4

成

6月21日，集邦咨询研究指出，2023年ChatBOT等生成式AI应用带动AI服务器成长热潮，又以大型云端业者最积极投入，包含Microsoft、Google、AWS或其他中系业者如Baidu、ByteDance等陆续采购高端AI服务器，以持续训练及优化其AI分析模型。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器（HBM）的需求，并将驱动先进封装产能2024年成长3-4成。预计2023年市场上主要搭载HBM的AI加速芯片，搭载HBM总容量将达2.9亿GB，成长率近6成，2024年将持续成长3成以上。（资料来源：全球半导体观察，集邦咨询）

市场需求下，OLED面板驱动芯片将从40nm向28nm制程迭代

6月21日，集微网称，据电子时报报道，近年来OLED面板驱动芯片（DDI）需求增幅明显，已成为各个厂商最重要的产品，同时这也是在市场环境疲软的背景下，少数几类销量没有明显减少的芯片。研究机构Omdia认为，现在几乎所有的晶圆代工厂扩增产能主要集中在28nm节点，联电也在计划缩减40-90nm工艺面板驱动芯片的产能。需求方面，各大主要智能手机品牌的面板供应链，也希望使用更高规格的芯片。在供需双方的推动下，预计目前28nm、40nm OLED DDI芯片的比例约为4:6，未来两年内将逐渐转变为6:4。除了在智能手机领域，可穿戴设备的增长，也带动了这类芯片的需求，预计未来将一直保持每年两位数的增长率。（资料来源：爱集微）

中国大陆将对第三代半导体需求强劲

6月24日，一些技术专家表示，预计未来几年中国大陆将对第三代半导体产生强劲需求，这些半导体产品主要用于电网、电动汽车和电信基站。新一代芯片，也称为复合芯片，由SiC和GaN等宽带隙材料制成，它们适用于功率器件，可以在高温、高频和高压的环境中工作。TrendForce表示，全球SiC功率器件市场的价值将从2022年的16.1亿美元攀升至2026年的53.3亿美元，复合年增长率为35%。GaN功率器件的年增长率将从2022年的1.8亿美元增长到2026年的13.3亿美元，CAGR为65%。（资料来源：半导体产业纵横）

Micro LED市场规模2028年达8亿美元，未来五年复合年增长率达70.4%

6月25日，据GlobeNewswire报告显示，预计到2028年，全球

Micro LED 显示器市场将达到约 8 亿美元，2023 年至 2028 年复合年增长率为 70.4%。报告显示，全球 Micro LED 显示器市场的未来前景广阔，消费电子、汽车、广告、航空航天和国防市场蕴藏着机遇。该市场的主要驱动力是市场对节能显示解决方案需求的不断增长，以及电子巨头对 Micro LED 显示器的偏好日益增加。（资料来源：爱集微）

3 公司动态

【基侑电子】半导体刻蚀设备生产项目正式签约，总投资 10 亿元
6 月 19 日，半导体刻蚀设备生产项目签约仪式举行。半导体刻蚀设备生产项目由昆山基侑电子科技有限公司投资，总投资 10 亿元，位于上饶高新区霞峰电子信息产业园，用地面积约 30 亩，主要生产晶圆刻蚀机、清洗机等设备。项目达产达标后，预计年产值可达 15 亿元人民币。（资料来源：全球半导体观察）

【芯视佳】12 寸硅基 OLED 项目正式开工
6 月 20 日，据科创板日报消息，近日，芯视佳 12 英寸硅基 OLED 产业园项目在安徽淮南市高新区正式开工。项目总投资 65 亿元，规划月产能达 4000 片晶圆，主要生产硅基 OLED 微显示屏，应用于 AR/VR 等领域，预计年产值达 35 亿元。两期完成投产后产值预计可达 100 亿元以上。项目计划于 2024 年 7 月份将搬入设备，12 月份点亮产品，2025 年正式进入量产阶段。（资料来源：VR 陀螺）

【ASML】数值孔径 0.75 超高 NA EUV 光刻设备 2030 年登场
6 月 21 日，全球半导体观察称，据日媒报道，光刻机设备龙头阿斯麦执行副总裁 Christophe Fouquet 近日在比利时 imec 年度盛会 ITF World 2023 表示，半导体产业需要 2030 年开发数值孔径 0.75 的超高 NA EUV 光刻技术，满足半导体发展。自 2010 年以来 EUV 技术越来越成熟，半导体制程微缩至 2020 年前后三年，以超过 50% 幅度前进，不过速度可能会在 2030 年放缓。到 2030 年，使用 High NA EUV 的多重图案将与单一图案一起完成，以提高产量，并降低制程成本，需要更高数值孔径的 EUV 曝光 (NA=0.75)。（资料来源：全球半导体观察）

【台亚半导体】正以 IDM 模式进军第三代半导体产业
6 月 21 日，据台湾媒体报道，台亚半导体正在以 IDM 模式进军第三代半导体产业，2023Q1 已试产氮化镓，2024 年试产碳化硅，

合计年产能约 10 万片。据台亚半导体宣布，他们将在中国台湾铜锣扩建 6 吋碳化硅晶圆厂和 8 吋、12 吋氮化镓晶圆厂，以及后段的测试、封装厂。台亚总经理衣冠君表示，该氮化镓厂将是全球少见的先进功率器件厂，预计在 2024 年底之前达成每月 3000 片的出货量，产品将聚焦于快充、电动汽车、无人机等应用。近期，台亚已完成第一颗 650V D-mode HEMT 的开发，并进行送样验证。他们预期在少量代工单生产之下，氮化镓有望在 23 年开始贡献营收。衣冠君认为，24 年公司氮化镓营收提升至 30% 的目标有望达成。（资料来源：行家说三代半）

【科友半导体】实现 8 吋 SiC 量产技术突破

6 月 22 日，科友半导体宣布，他们实现了 8 英寸 SiC 单晶的量产关键技术突破，在晶体尺寸、厚度、缺陷控制、生长速率、制备成本及装备稳定性等方面取得可喜成绩。目前，科友半导体 8 英寸 SiC 中试线平均长晶良率已突破 50%，晶体厚度 15mm 以上，有望成为我国大尺寸低成本碳化硅规模化量产制造技术的领跑者。（资料来源：行家说三代半）

【山西天成半导体】成功研发出 8 吋 SiC 单晶

6 月 22 日，“行家说三代半”在调研中了解到，国内还有 1 家企业——山西天成半导体——也实现了 8 吋 SiC 单晶技术研发突破。天成半导体透露，他们这次开发出的 8 吋 SiC 单晶直径达到 202mm，各项参数指标良好。天成半导体成立于 2021 年 8 月成立，2022 年 4 月，天成半导体仅用半年时间就顺利完成了中试投产，已经实现了 6 英寸导电型和半绝缘型碳化硅晶圆的小批量生产。（资料来源：行家说三代半）

4 公司公告

表 2: A 股公司要闻核心要点 (06.19-06.21)

日期	公司	公告类型	要闻
2023-06-20	中微半导	股权激励	本激励计划首次授予的激励对象由 156 人调整为 150 人, 前述 6 名激励对象对应的拟授予限制性股票份额调整给本激励计划首次授予的其他激励对象, 首次授予总量保持不变, 为 480 万股。授予价格由 25.00 元/股调整为 24.55 元/股。
2023-06-20	萤石网络	限售股上市	本次上市流通的网下配售限售股数量为 5,191,576 股, 占公司股本总数的 0.9229%, 限售期为公司上市之日起 6 个月。本次上市流通日期为 2023 年 6 月 28 日。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。
2023-06-21	纳芯微	限售股上市	公司本次上市流通的限售股股份数量为 2,205,000 股, 占公司股本总数的 1.56%, 限售期为自取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月。本次上市流通日期为 2023 年 6 月 30 日。
2023-06-22	可立克	资金投向	受 2022 年国内经济增长放缓、2022 年新能源汽车补贴政策退坡等因素影响, 公司计划将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日; 将“汽车电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

资料来源: Wind, 上海证券研究所

5 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧

中美贸易摩擦加剧, 美方加大对国内企业的制裁力度, 部分公司的经营或受到较大影响。

2) 终端需求不及预期

下游终端需求不及预期, 产业链相关公司业绩或发生较大波动。

3) 国产替代不及预期

国产替代不及预期, 国内企业的业绩或将面临承压。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。